

# 半導體工程系「暑期實習、學期實習、學年實習」申請流程

公告日期：113年4月2日

階段	112-2 學期	流程說明
實習前	公告日至第12週	<b>實習申請</b> (班代於期限內收齊資料繳交至系辦，逾時不受理) 需繳交(紙本)資料： 1. <b>實習申請表(每1人1張)</b> ：欲實習學生須填寫，並請本系實習輔導老師簽名。 2. <b>實習機構基本資料與評估表</b> ：同一實習機構填寫一份即可。 收件截止日期： <b>113/5/10(五)17:00</b>
	第13週	<b>召開系(所)學生職場實習委員會</b>
	第13週至第14週	<b>通過實習機構審查，繳交資料</b> (班代於期限內收齊資料繳交至系辦，逾時不受理) 需繳交(紙本)資料： 1. <b>個別實習計畫</b> ：學生需與實習機構討論實習內容，將其文字填寫於個別實習計畫，確認無誤後，實習機構輔導老師、學生本人及家長於『個別實習計畫同意簽署處』簽名後，最後請本系實習輔導老師確認簽名。 2. <b>職場實習合約書(每1人1份)</b> ： <b>雙面列印(1式3份)</b> 完成實習機構大小章及騎縫章。 收件截止日期： <b>113/5/24(五)17:00</b>
	第15週至第17週	<b>合約書校方用印、辦理學生保險</b>
	第18週	<b>實習前說明會(召集學生，建立實習達人網基本資料)</b>
實習中	實習期間	<b>實習輔導老師訪視實習學生</b> 需填報(實習達人網 <a href="http://163.18.94.122/Default.aspx">http://163.18.94.122/Default.aspx</a> )及繳交照片(電子檔)： 1. <b>訪視紀錄表</b> ：系辦通知實習輔導老師至平台填報。 2. <b>實地訪視照片</b> ：每次訪視需拍 <b>3~5張照片</b> ，請學生或老師回傳至系辦。 ★暑期實習：訪視紀錄至少2次，其中實地至少1次。 ★學期實習：訪視紀錄至少2次，其中實地至少1次。 ★學年實習：每學期訪視紀錄至少2次，其中實地至少1次。
實習後	開學後	<b>實習結束前，繳交成果資料</b> 需填報(實習達人網 <a href="http://163.18.94.122/Default.aspx">http://163.18.94.122/Default.aspx</a> )及繳交(紙本)資料： 1. <b>實習生滿意度調查表</b> ：由學生至平台填報。 2. <b>實習成績考核表</b> ：實習輔導老師及實習機構填報。 3. <b>實習機構滿意度調查表</b> ：實習輔導老師填報。 4. <b>職場實習課程實習作業</b> ：由學生繳交至系辦(含簽名) 實習成果座談會(實習成果未發表者，該項目成績為0分) ★暑期實習：開學後第1次系週會發表。 ★學期實習：當學期第2次系週會發表。 ★學年實習：每學期第2次系週會發表。

以上實習資料電子檔放置「系網-表單下載專區」

系辦聯絡窗口：07-3617141 分機 23352